

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年3月6日(06.03.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/047971 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 23/12 (2006.01) H05K 3/46 (2006.01)
H05K 1/02 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/031365

(22) 国際出願日: 2024年8月30日(30.08.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-142509 2023年9月1日(01.09.2023) JP

(71) 出願人: 三井金属鉱業株式会社
(MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1418584 東京都品川区大崎一丁目11番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 柳井 威範(YANAI Takenori); 〒3620021
埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属
鉱業株式会社内 Saitama (JP). 北畠 有紀子
(KITABATAKE Yukiko); 〒3620021 埼玉県上

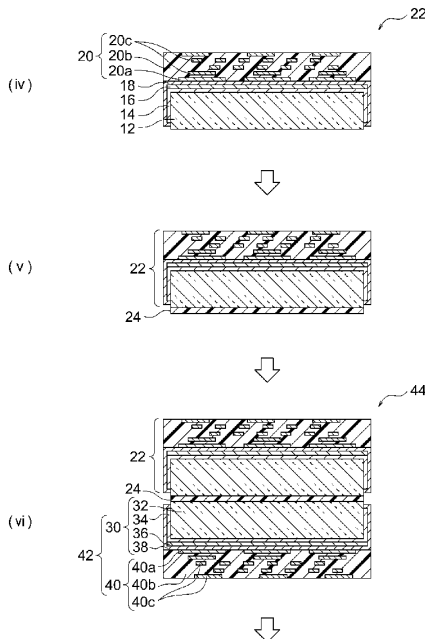
尾市原市1333-2 三井金属鉱業株式
会社内 Saitama (JP). 松浦 宜範(MATSUURA
Yoshinori); 〒3620021 埼玉県上尾市原市133
3-2 三井金属鉱業株式会社内 Saitama (JP).

(74) 代理人: 高村 雅晴, 外(TAKAMURA Masaharu
et al.); 〒1760001 東京都練馬区練馬1丁目4
番1号 ユニティフォーラム11 6階 マク
スウェル国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING REDISTRIBUTION STACK, AND CARRIER-ATTACHED METAL FOIL

(54) 発明の名称: 再配線積層体の製造方法及びキャリア付金属箔



(57) Abstract: Provided is a method for manufacturing a redistribution stack with which warpage can be reduced. This method for manufacturing a redistribution stack comprises: a step for obtaining a first stack by forming a first redistribution layer having a thickness of 100 μm or less on a first metal layer of a first-carrier-attached metal foil that has a first carrier, a first peeling layer, and the first metal layer in this order; a step for preparing a second stack having a second redistribution layer or a dummy insulating layer having a thickness of 100 μm or less on the second carrier; and a step for obtaining a third stack by bonding the first carrier of the first stack and the second carrier of the second stack via an adhesive layer containing an adhesive material.

(57) 要約: 反りを低減可能な再配線積層体の製造方法が提供される。この再配線積層体の製造方法は、第1キャリア、第1剥離層、及び第1金属層をこの順に備えた第1キャリア付金属箔の第1金属層上に、厚さ100 μm 以下の第1再配線層を形成して、第1積層体を得る工程と、第2キャリア上に、厚さ100 μm 以下の第2再配線層又はダミー用絶縁層を備えた、第2積層体を用意する工程と、第1積層体の第1キャリア及び第2積層体の第2キャリアを、接着性材料を含む接着層を介して貼り合わせて、第3積層体を得る工程とを含む。

WO 2025/047971 A1

[続葉有]

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))